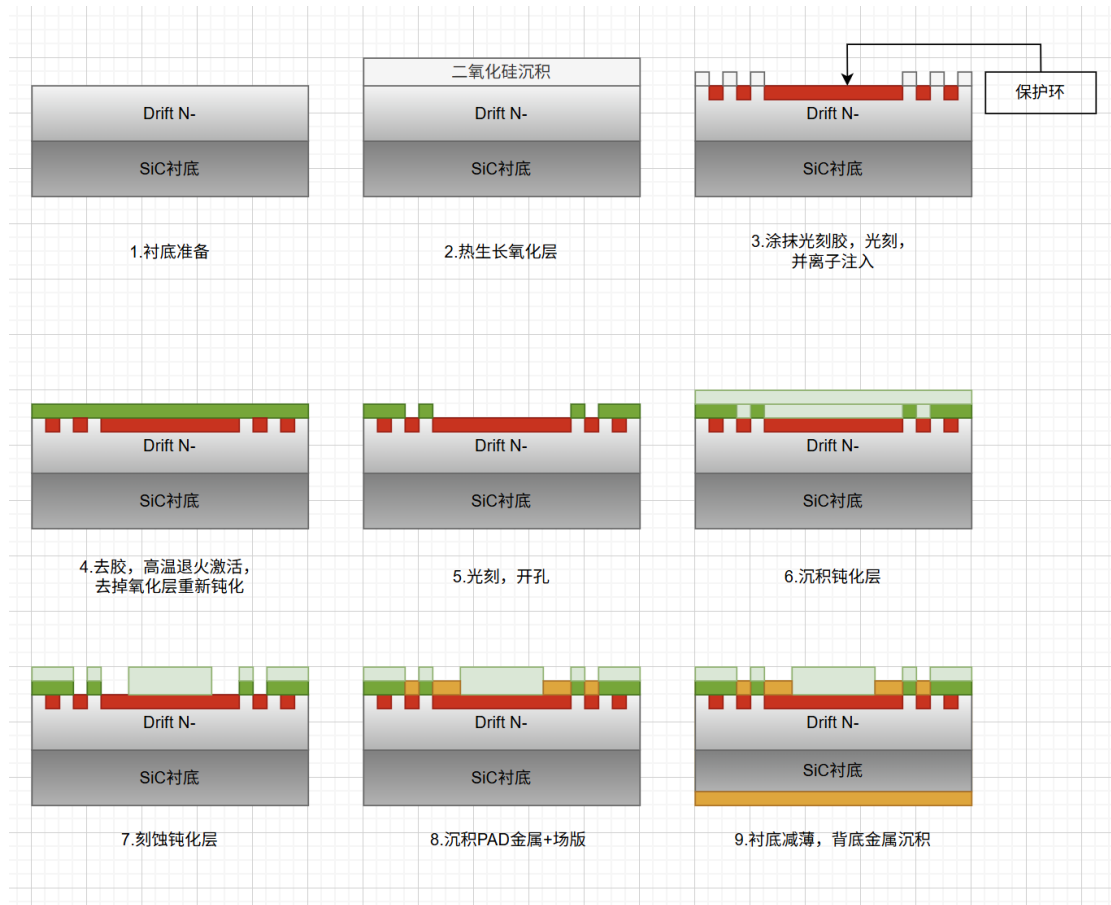
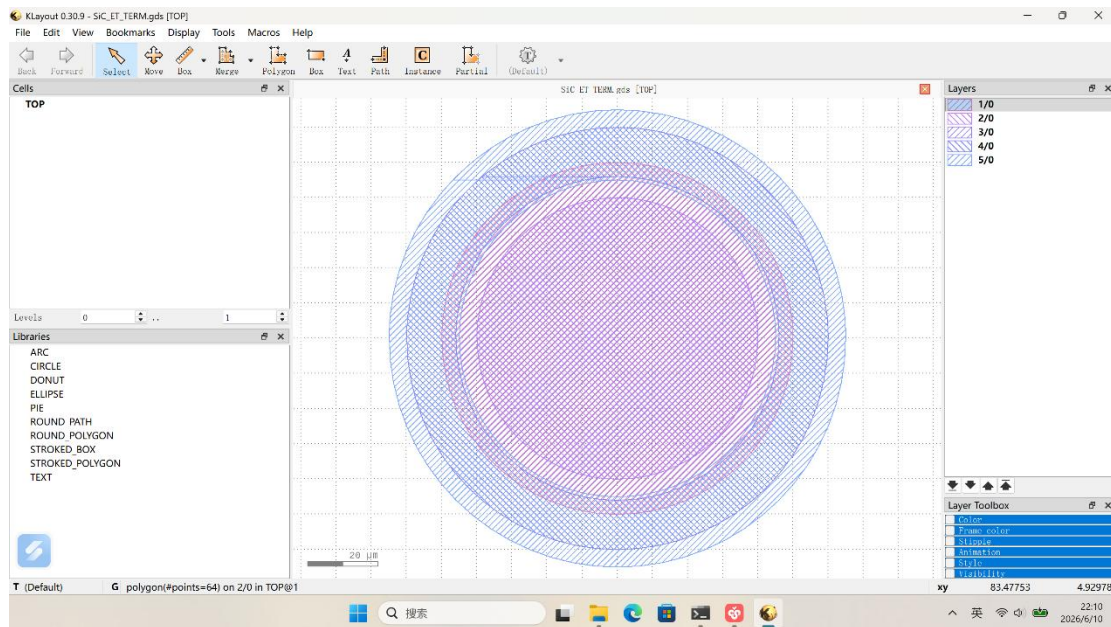


1.



2.



光刻板	目的	掩模类型	光刻胶	掩模上的图形	晶圆上结果
M1_TERM	定义台面，刻蚀外围	亮场 (Clear field)	正胶	中心实心圆 (铬)	圆内保留，圆外刻掉
M2_CONT	刻蚀氧化层，开出欧姆接触孔	暗场 (Dark field)	正胶	中心实心圆 (透明)	圆内开孔，圆外保留氧化层
M3_OHMIC	保护欧姆金属不被刻蚀	亮场 (Clear field)	正胶	实心圆形金属块 (铬)	圆内金属留下，圆外金属被刻掉
M4_PADOPEN	刻蚀上层钝化层，开出 PAD 连接孔	暗场 (Dark field)	正胶	圆环形 (透明)	环内开孔，其余保留钝化层
M5_PADMETAL	保护 PAD 金属+场板不被刻蚀	亮场 (Clear field)	正胶	圆环形金属 (铬)	环内金属留下，其余金属被刻掉